

2023年6月期 決算説明会資料

株式会社テクニスコ
2023年8月30日



1.	事業概要	P. 02
2.	2023年6月期の業績概要と2024年6月期の見通し	P. 14
3.	今後の成長戦略	P. 26
4.	Appendix	P. 31



1. 事業概要



会社名	株式会社テクニスコ
本社	東京都品川区南品川2-2-15
代表者	関家 圭三
設立	1970年2月14日
資本金	687,585,600円 (2023年7月25日時点)
従業員数	単体204名、連結322名 (2023年6月末日現在)
事業内容	ヒートシンク製品、ガラス製品及びその他の精密加工部品の製造、販売
連結子会社	TECNISCO(SuZhou)CO.,Ltd. TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.



クロスエッジ®Technologyについて



クロス
混ぜる⇒掛け合わせる

エッジ
先端⇒先端技術

ドイツ (ミュンヘン) /
TECNISCO EUROPE GmbH



シンガポール / TECNISCO
Advanced Materials Pte. Ltd.



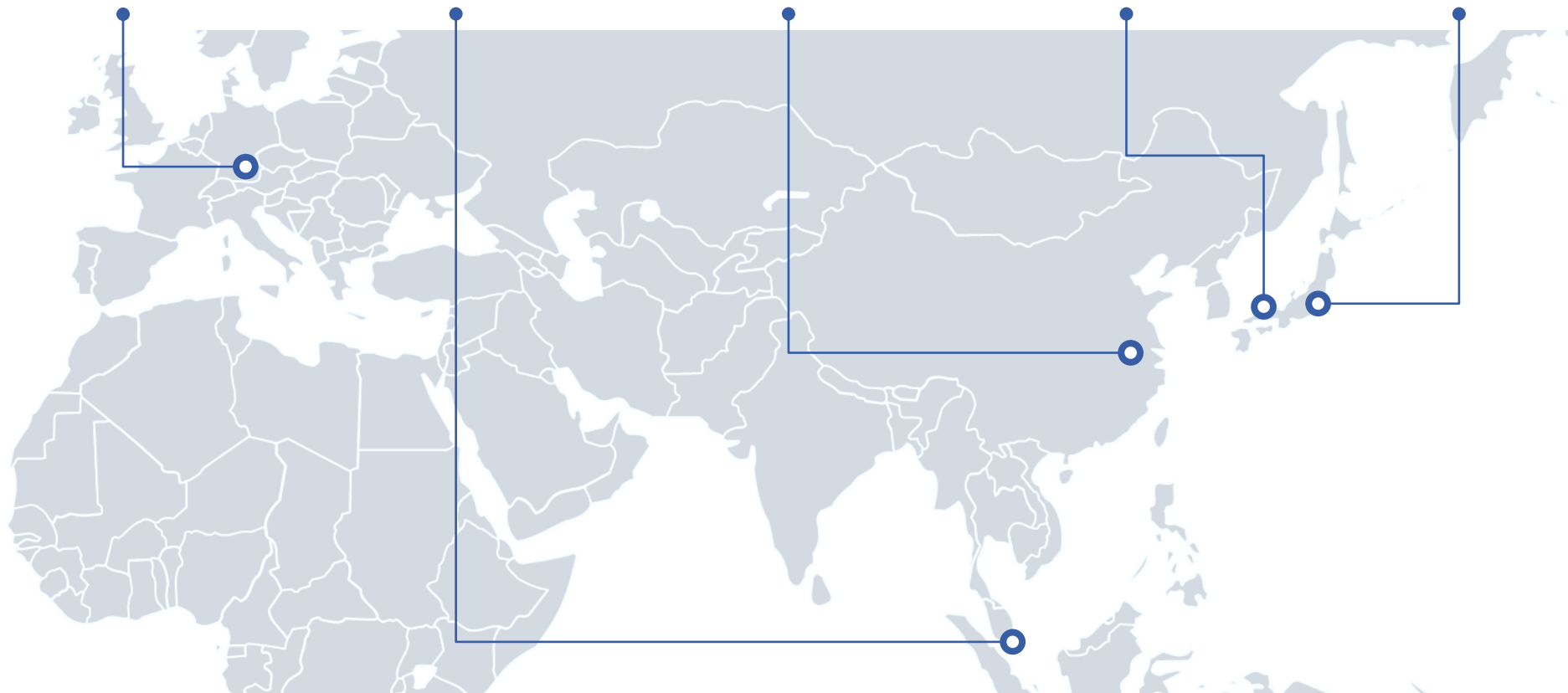
中国 / TECNISCO
(SuZhou) CO.,Ltd.



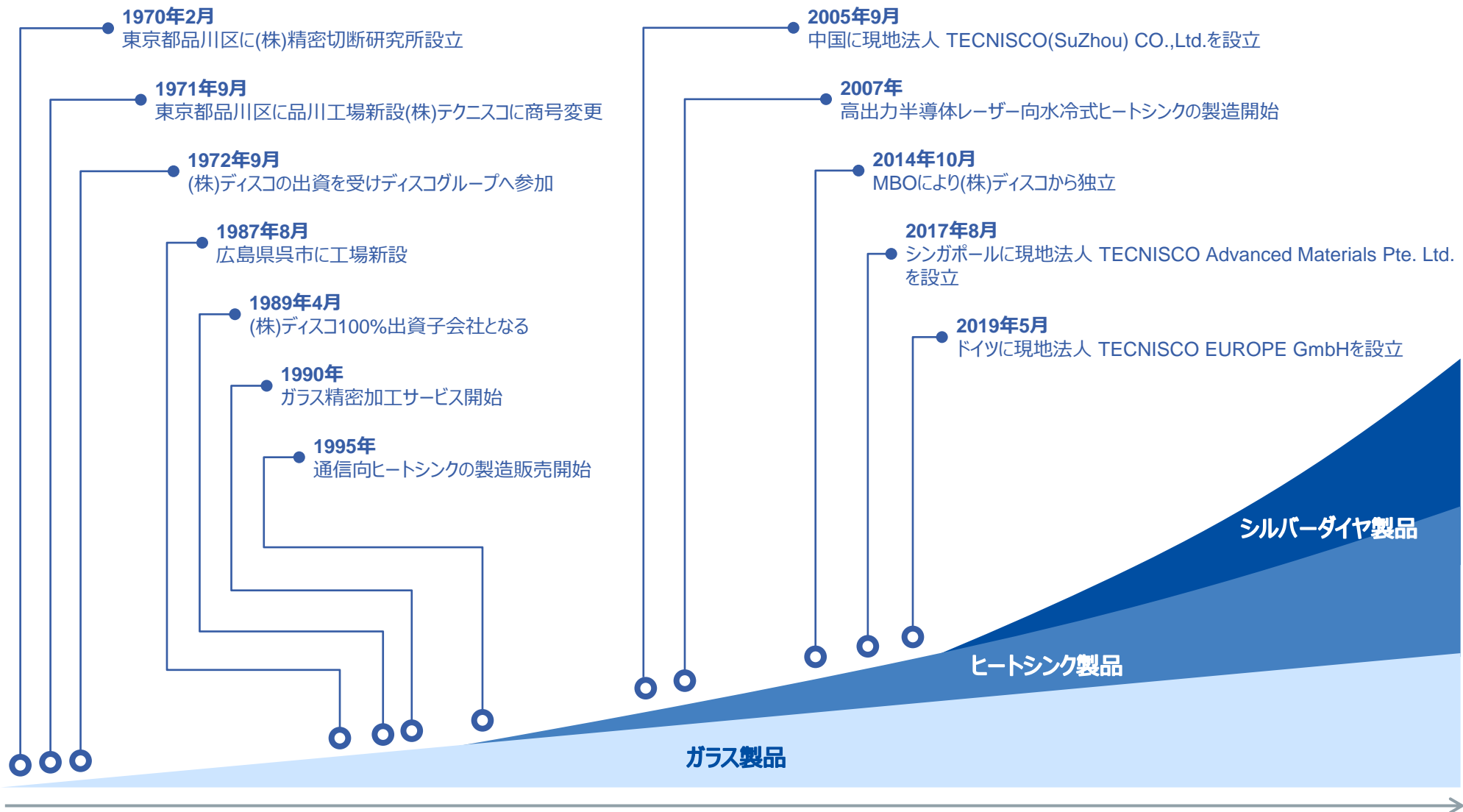
広島工場



東京本社



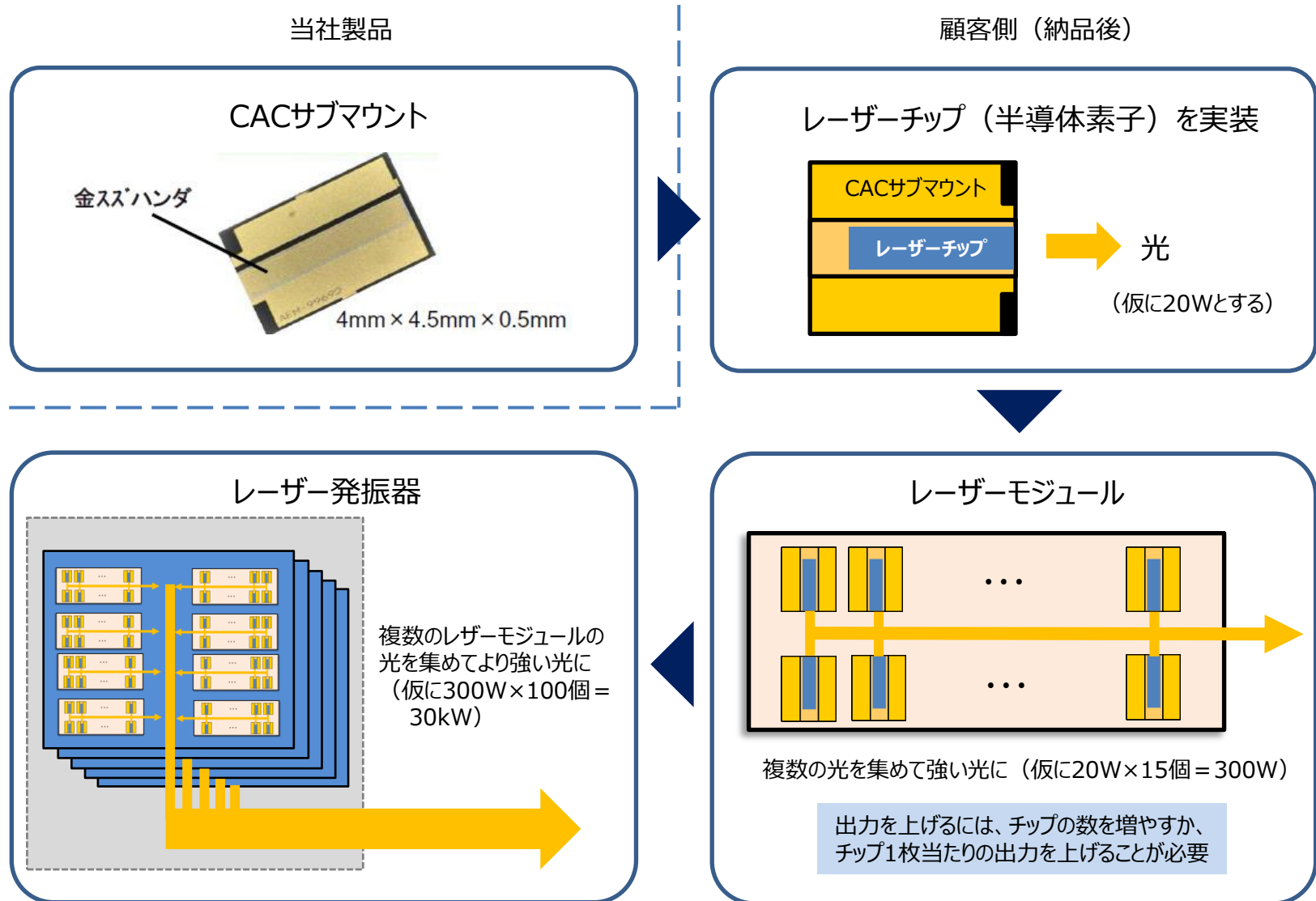
テクニスコの歩み



当社の製品と産業バリューチェーン



例) 当社製品が産業用レーザーに組み込まれるイメージ



ヒートシンク製品

AINやCuWを形状加工して独自ノウハウで金属を成膜

サブマウント

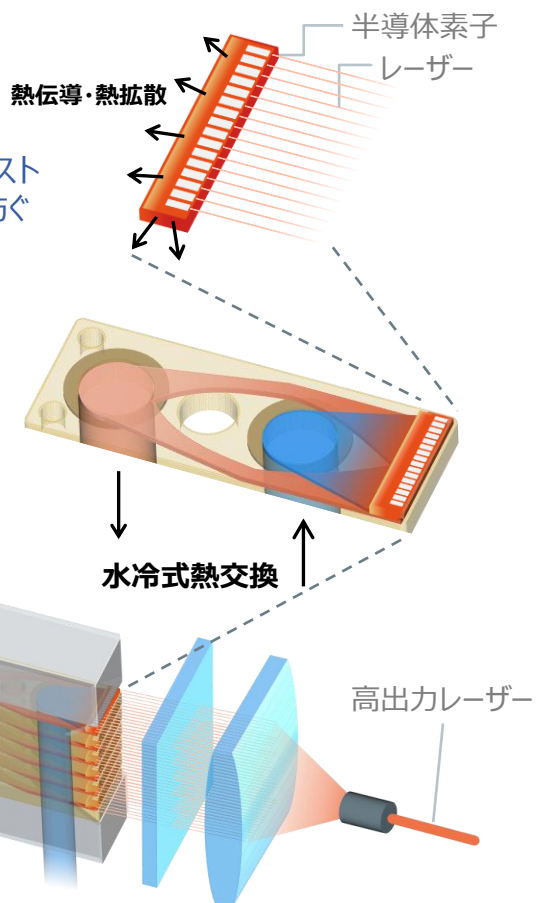
優れた熱伝導性で半導体素子の熱ストレスを低減（半導体素子の故障を防ぐため、熱膨張率を合わせる必要あり）



CACサブマウント
銅・窒化アルミ・同
のサンドイッチ



CuWサブマウント
銅タングステン



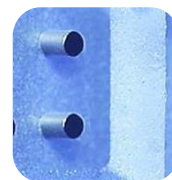
ガラス製品

電子部品用ガラスに特殊加工を施し販売

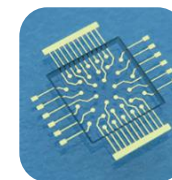
電子部品用ガラスの特長

- 光透過性
- 電気的絶縁性
- 気密性
- 耐薬品性

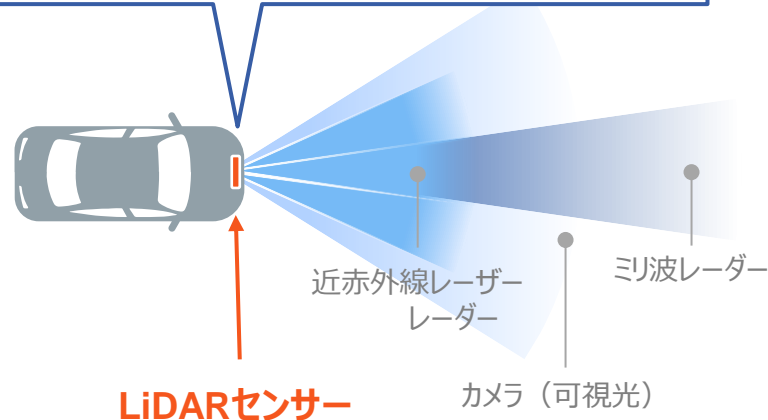
自動運転用のLIDARセンサーでも活用されている



ガラス貫通電極

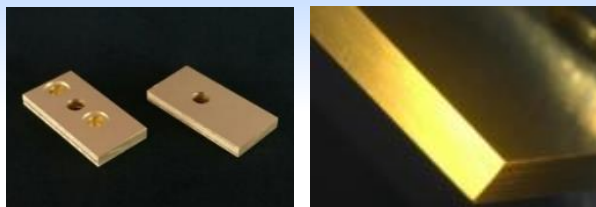


ガラス立体配線



クロスエッジ®Technology (使用例)

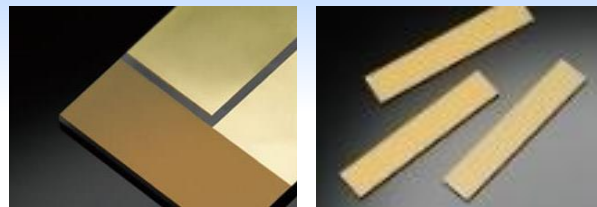
マイクロチャンネルクーラー



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

特に接合の「熱拡散工法」はテクニスコ独自の技術

CACサブマウント



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

メタライズでは「スパッタ」「めっき」「蒸着」の3要素を使用

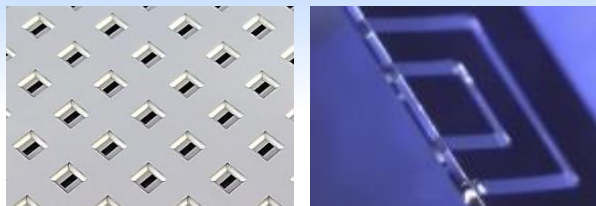
キャップガラス配線貫通電極



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

「接合」「3D配線」「TGV」の3要素複合はテクニスコ独自の技術

シリコンガラス構造体



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

ガラス + シリコンの接合による
一体成型はテクニスコ独自の技術

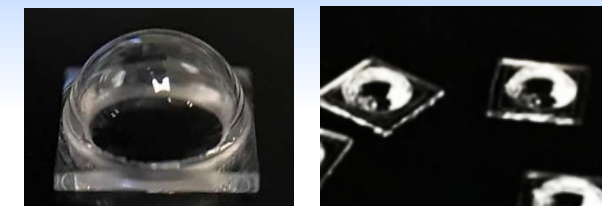
側面出射キャップガラス



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

箱型で側面が透明な構造はテクニスコ独自の技術

ドーム型キャップガラス



- Cutting 切る
- Grinding 削る
- Polishing 磨く
- Metalizing メタライズ
- Boning 接合

ドーム成形法はテクニスコ独自の技術

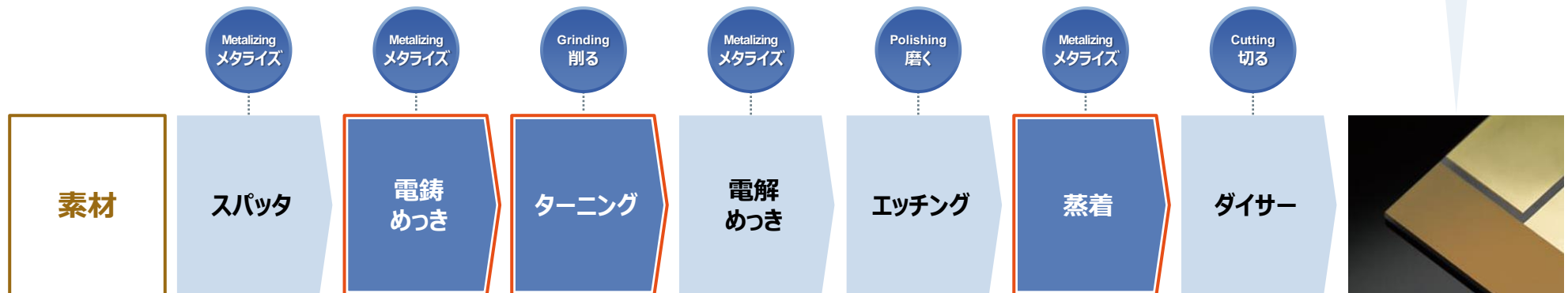
クロスエッジ®Technologyの強み

- すべての加工を自社で行えるため、工程の最適化、品質のコントロール、リードタイム短縮が可能
- ノウハウの蓄積により、競争優位性のある技術の獲得が可能

例) CACサブマウントの工程と競争優位性のある技術

□ 特に、競争優位性のある技術

- 厚みの精度、形状寸法が良好
- 優れたハンダ濡れ性 / パターン精度による高い信頼性



技術・ノウハウの蓄積により、めっき厚付けの信頼性向上を実現

技術・ノウハウの蓄積により、端面のバリを抑えることが可能

条件設定が非常に重要であり、20年以上のノウハウの蓄積により、ハンダの濡れ性やパターン精度を安定化

現在、当社製品が特に多く使われている市場

市場・用途

産業機器



- 溶接用レーザー機器
- 切断用レーザー機器
- 表面処理レーザー機器 など

ライフサイエンス



- 医療用レーザー
- デジタル複合機用レーザー
- 分析機器用レーザー など

光・無線通信



- 通信用レーザー機器 など

自動車

- 車載用レーザーデータリンク など

データセンター

- サーバーCPU
- パワー半導体、MPUなど

航空宇宙

- 高周波通信機器 など

現在、当社製品が特に多く使われている市場

市場・用途

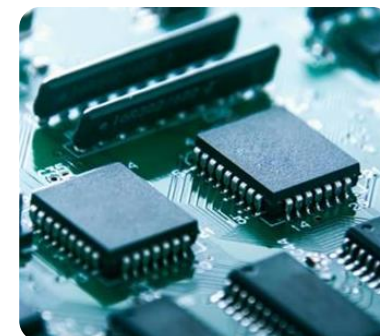
自動車

- LiDARセンサー
- 圧力センサー
- ジャイロセンサー
- 高輝度LED など



産業機器

- 高周波(RF)スイッチ
- 画像センサー など



ライフサイエンス

- 内視鏡
- DNA分析器
- 血液分析器 など



環境エネルギー

- 発電センサー
- 光（赤外・紫外）センサー
- 殺菌装置 など



2. 2023年6月期の業績概要と 2024年6月期の見通し



2023年6月期 業績サマリー

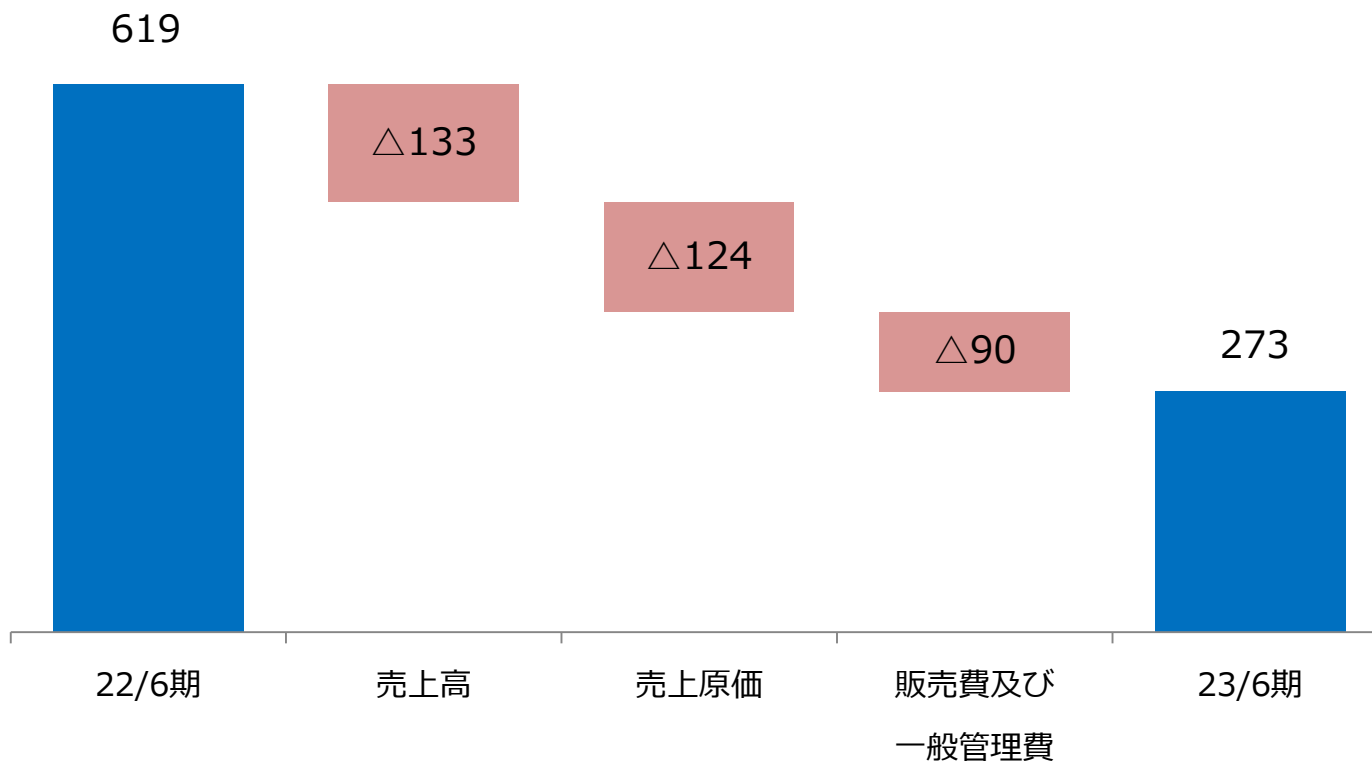
(単位：百万円)	2022年6月期	2023年6月期	前年比
売上高	5,480	5,347	△2.4%
売上総利益	2,206	1,949	△11.6%
売上総利益率 (%)	40.3%	36.5%	△3.8 pt
営業利益	619	273	△55.9%
営業利益率 (%)	11.3%	5.1%	△6.2 pt
経常利益	887	329	△62.9%
経常利益率 (%)	16.2%	6.2%	△10.0 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	802	222	△72.3%

為替実績レート
 USD : 138.09円
 EUR : 144.90円
 RMB : 19.70円

- 《売上高》主力製品である産業用レーザー向けヒートシンクにおいて、上半期に中国のゼロコロナ政策等の影響から、出荷数量の一時的な調整が入ったために減少（ただし、2023年1月以降は出荷ペースが回復、新規取引先からの受注も増加）
- 《利益》中国向け製品の生産調整の影響から、広島工場の稼働率が一時的に低下、また、今後の事業拡大に向けた人員増加や設備投資の影響等により、各利益率が前年より減少

2023年6月期 営業利益の増減要因分析

(単位：百万円)



売上高

主力製品の産業用レーザー向けヒートシンクにおける上期の一時的な販売数量減の影響

売上原価

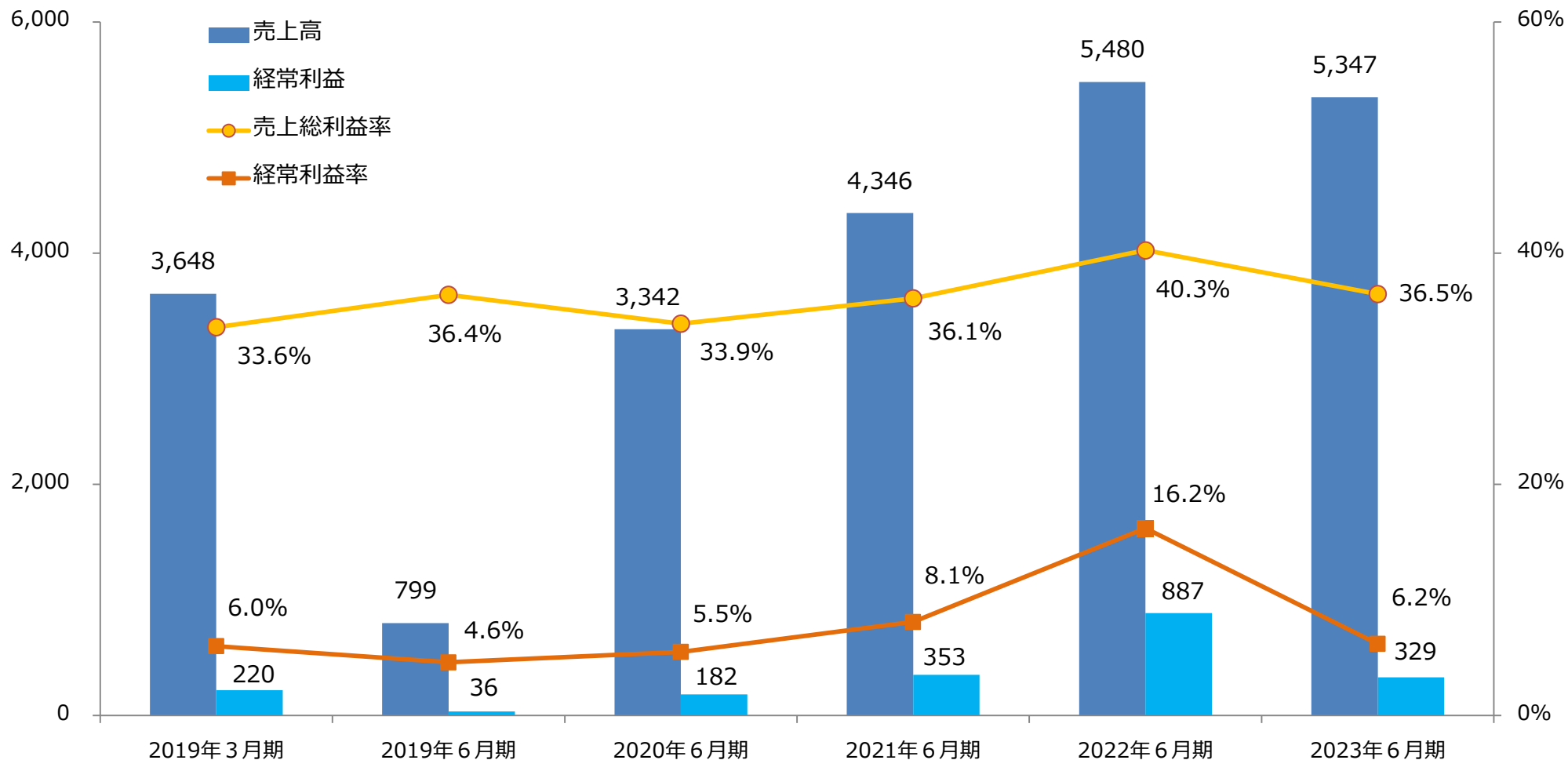
広島工場の稼働率の一時的な低下、および、事業拡大に向けた人員増加や設備投資の影響等

販売費及び一般管理費

事業拡大に向けた人員増加や設備投資、上場関連費用の影響等

重要指標の推移

(単位：百万円)

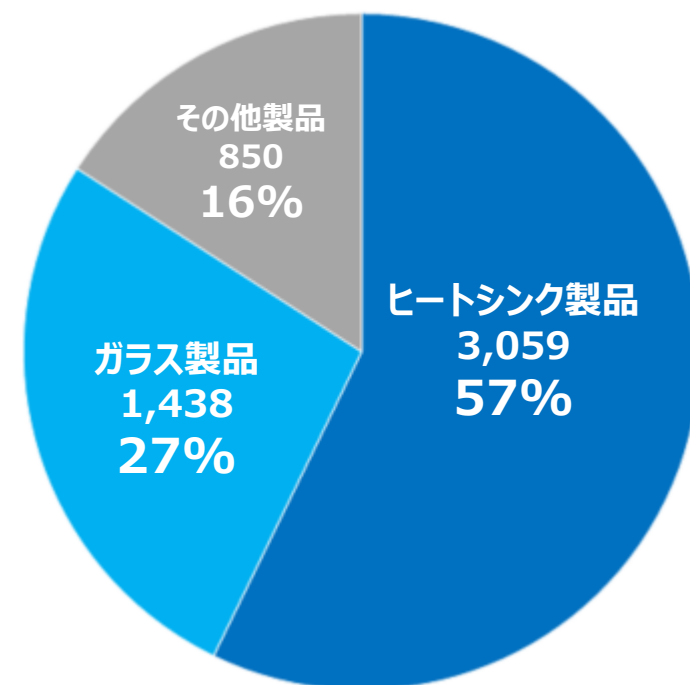


※ 2019/3期～2020/6期は単体、2021/6期以降は連結の数値を使用
 ※ 2019/6期は3か月の変則決算

製品別売上高



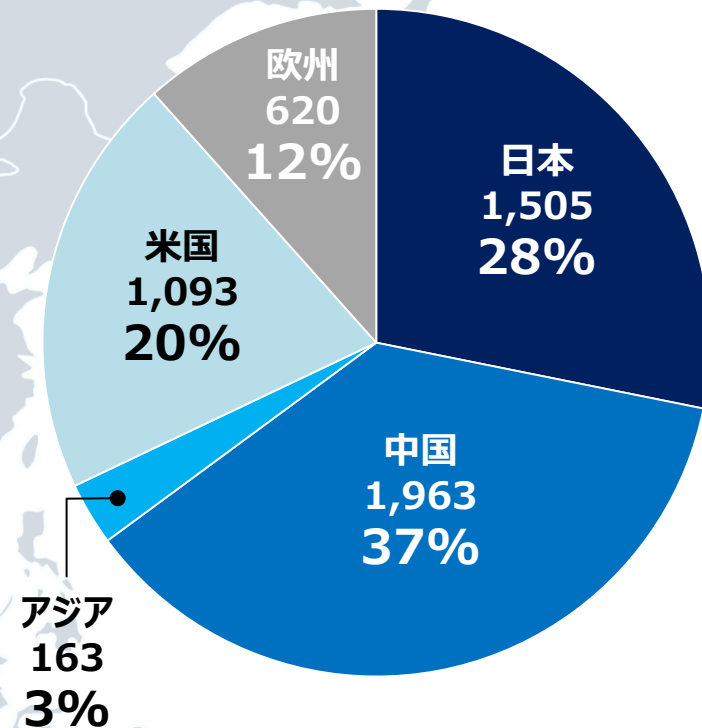
(百万円)	2022年6月期		2023年6月期		前年比
		構成比		構成比	
ヒートシンク製品	3,291	60%	3,059	57%	△232
ガラス製品	1,219	22%	1,438	27%	+219
その他	970	18%	850	16%	△120
合計	5,480	100%	5,347	100%	△133



- ・《**ヒートシンク製品**》主力製品の産業用レーザー向けヒートシンクにおいて、上半期に中国のゼロコロナ政策等の影響から出荷数量の一時的な調整が入ったために減収
- ・《**ガラス製品**》海外のライフサイエンス市場向けを中心に、検査用の消耗部品の需要が増加したことなどにより増収

地域別売上高

(百万円)	2022年6月期		2023年6月期		前年比
		構成比		構成比	
日本	1,484	27%	1,505	28%	+21
中国	2,275	42%	1,963	37%	△312
アジア	152	3%	163	3%	+11
米国	862	16%	1,093	20%	+231
欧州	706	13%	620	12%	△86
合計	5,480	100%	5,347	100%	△133



- ・《**中国市場**》主力製品の産業用レーザー向けヒートシンクにおいて、上半期にゼロコロナ政策等の影響から出荷数量の一時的な調整が入ったために減収
- ・《**米国市場**》ガラス製品の好調と、レーザー加工機メーカーにおいてヒートシンク製品の売上が増えたこと等により増収

(単位：百万円)	2022年6月期	2023年6月期	前年比	主な要因
総資産	8,140	8,271	+130	
流動資産	3,858	3,822	△35	(流動資産)
(現金及び預金)	835	845	+9	原材料及び貯蔵品：+97 商品及び製品：△150
(棚卸資産)	1,097	1,077	△20	(固定資産)
固定資産	4,282	4,449	+166	建設仮勘定：+155
(有形固定資産)	3,632	3,854	+221	
負債合計	4,622	4,531	△90	(流動負債)
流動負債	3,611	2,306	△1,304	支払手形及び買掛金：△240 短期借入金：△682 未払法人税等：△187
固定負債	1,011	2,225	+1,214	(固定負債) 長期借入金：+1,193
純資産	3,518	3,739	+220	
自己資本比率 (%)	43.2	45.2	+2.0 pt	

キャッシュフローのポイント

(単位：百万円)	2022年6月期	2023年6月期	前年比	主な要因
営業キャッシュ・フロー	1,042	361	△681	税金等調整前当期純利益：△589
投資キャッシュ・フロー	△634	△ 792	△158	有形固定資産の売却による収入：△132
財務キャッシュ・フロー	△247	416	+663	短期借入金の純減少額：△702 長期借入れによる収入：+1,980 長期借入金の返済による支出：△603
フリー・キャッシュ・フロー	408	△ 431	△839	
現金及び現金同等物の 期末残高	835	729	△106	

2024年6月期の見通し

(単位：百万円)	2023年6月期	2024年6月期	前年比
売上高	5,347	6,475	+21.1%
売上総利益	1,949	2,143	+10.0%
売上総利益率 (%)	36.5%	33.1%	△3.4 pt
営業利益	273	427	+56.5%
営業利益率 (%)	5.1%	6.6%	+1.5 pt
経常利益	329	420	+27.7%
経常利益率 (%)	6.2%	6.5%	+0.3 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	222	301	+35.6%

2024年6月期

前提為替レート

USD : 133円

EUR : 143円

RMB : 19.3円

為替感応度

USD : 約15百万円

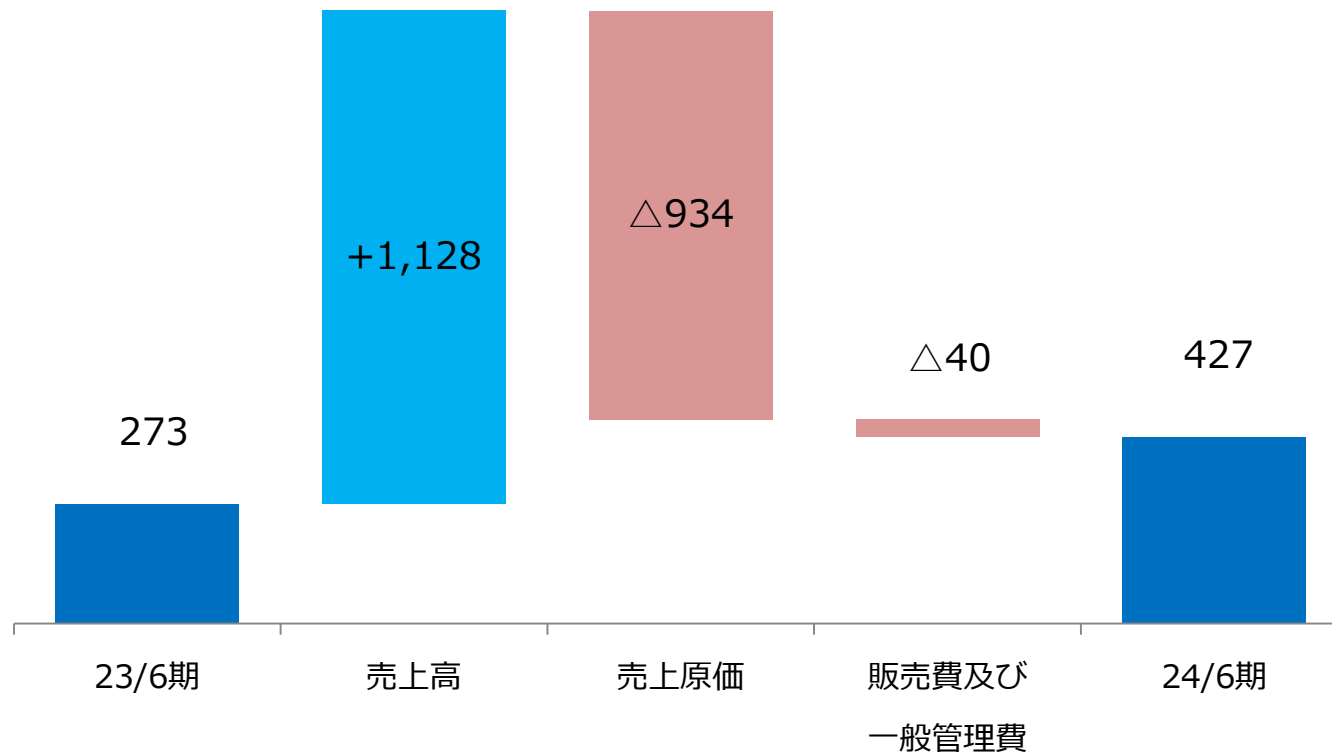
EUR : 約2百万円

RMB : 約140百万円

- ・《売上高》 主力製品の産業用レーザー向けヒートシンクにおいて、既存取引先からの注文数量の拡大傾向が顕著に見られることや、最終顧客のレーザー設備の高出力化の動きなどから、2023年6月期の落ち込みから回復し、さらに成長していく見込み
- ・《売上総利益率》 前期に引き続き、今後の事業拡大に向けた人員増加や設備投資の影響等により、若干低下する見込み
- ・《営業利益率》 販管費抑制の成果により、若干の増加の見込み

2024年6月期 営業利益の増減要因分析

(単位：百万円)



売上高

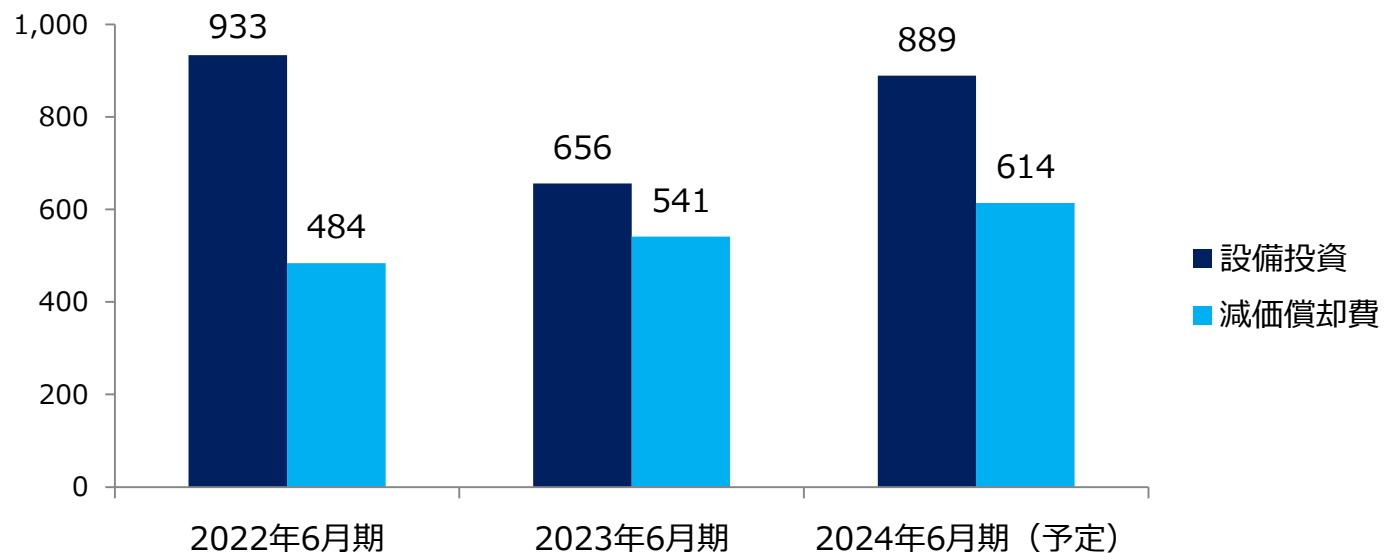
主力製品の産業用レーザー向けヒートシンクの回復や、ライフサイエンス・自動車市場向けのガラス製品の好調の影響

売上原価

売上高増加による影響、及び今後の事業拡大に向けた人員増加や設備投資の影響等

販売費及び一般管理費

今後の事業拡大に向けた人員増加や設備投資の影響



主な設備投資

広島工場



新工場の建設
約12億円
(2022～2026)

設備増強
約5億円
(2025～2026)

中国／TECNISCO (SuZhou) CO.,Ltd.



工場移転
約4億円
(2023～2024)

シンガポール／TECNISCO Advanced Materials Pte. Ltd.



設備増強
約2億円
(2023～2025)

基本方針

利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としています



23年6月期：株式公開前のため無配

24年6月期：現在、将来の事業展開に向けた投資とのバランスを勘案しながら配当開始に向けた検討を進めています

3. 今後の成長戦略



1 今後、狙う事業領域

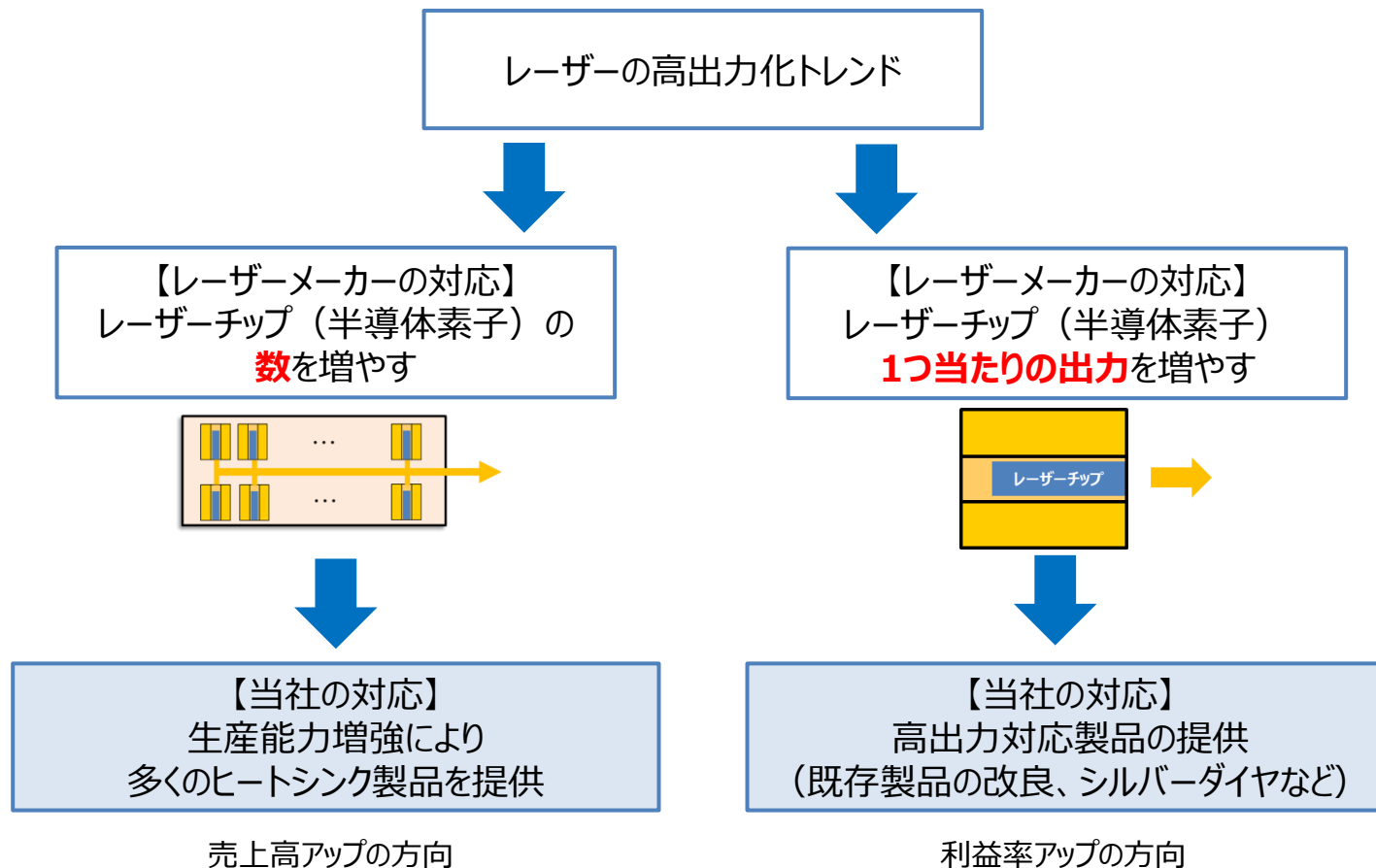
自動運転、データセンター、高出力レーザーなど
様々な成長市場をターゲットとします

2 変わらない基本戦略

継続的な設備投資によりクロスエッジ®Technologyを強化し、
「次も」期待される存在であり続けます

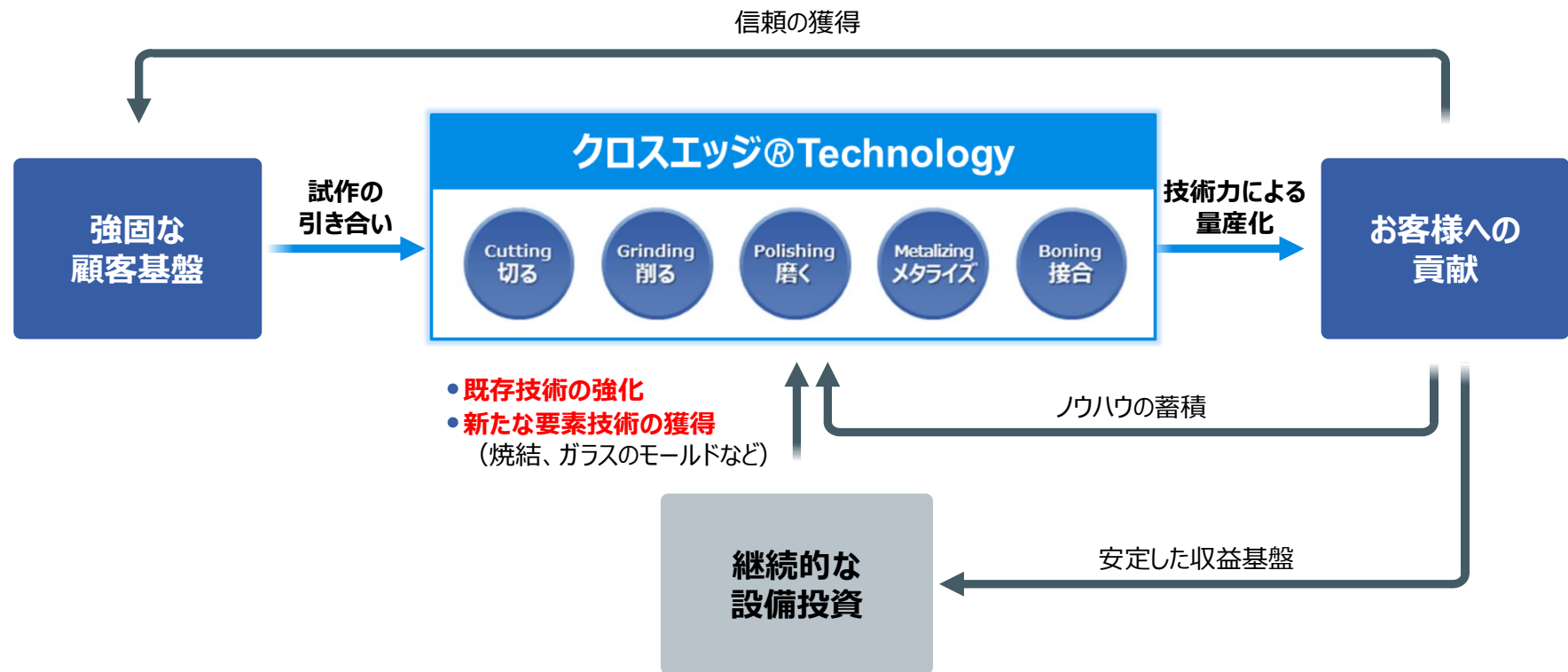
3 今後に向けた大きな転換点

レーザー市場の高出力化などに対応し、
初の独自材料製品であるシルバーダイヤを展開していきます



いずれの方法でもレーザーの高出力化に対応可能であり
お客様に貢献することで当社も成長

継続的な設備投資によりクロスエッジ®Technologyを強化、「次も」期待される存在に



初の独自材料製品、シルバーダイヤ

レーザー市場の高出力化などに対応し、初の独自材料製品であるシルバーダイヤを展開

シルバーダイヤの想定用途



メタルダイヤモンドコンポジット

- ヒートシンクの小型化
- 水冷の空冷化
- サーバ液冷の回避
- 機器の高出力化
- 機器の高性能化

用途

産業機器



- 溶接用レーザー機器
- 切断用レーザー機器 など

先端技術



- データセンター
- 高速通信



- 電気自動車 など

航空宇宙



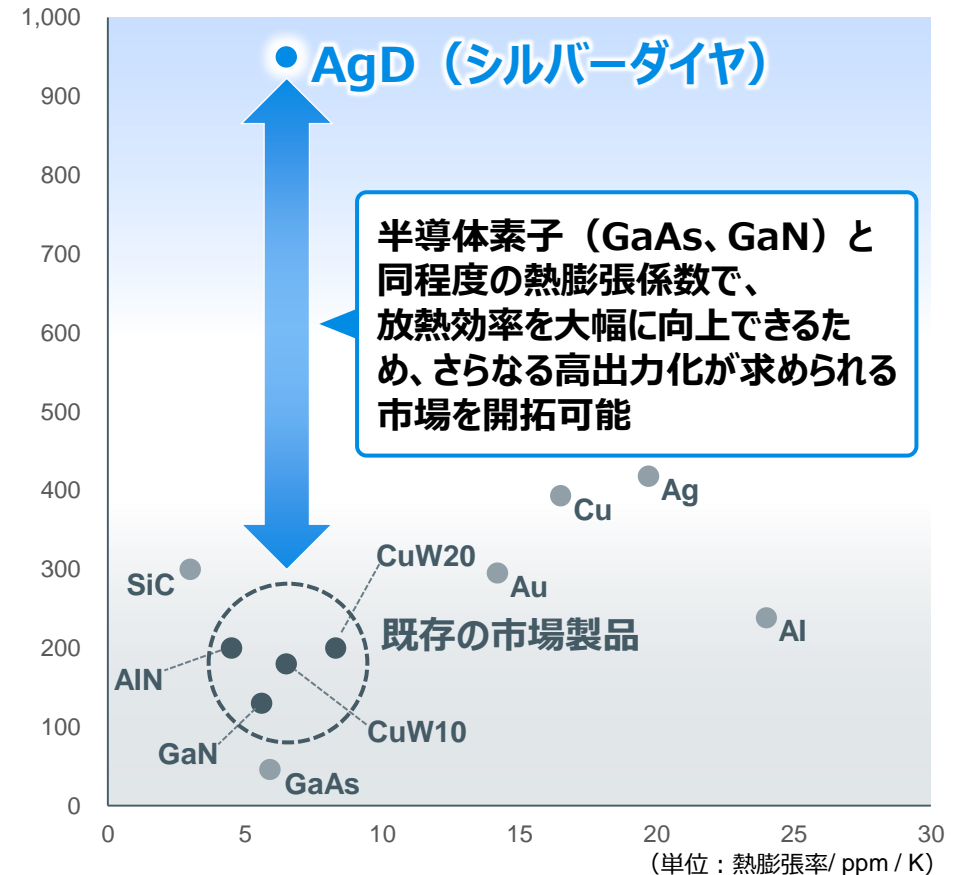
- ロケット、人工衛星



- 航空機 など

シルバーダイヤの特性

(単位：熱伝導率 / W / mK at 20°C)



4. Appendix.





ニーズに応じて蓄積されたノウハウ

時代によって変化するニーズに応え、様々な市場に高付加価値製品を提供するノウハウを蓄積

1970s

1980s

1990s

2000s

2010s

2020s

その時代の産業をリードする製品



- 磁気カセット



- CD、DVD光ピックアップ
- 各種センサー(車載等)
- 半導体 拡散ポート



- 衛星



- 光ファイバー通信
- プロジェクター



- 産業用レーザー加工機
- スマートフォン
- DNA解析装置
- 医療用チップ



- 高輝度プロジェクター
- LiDAR

継続的な設備投資

技術力の強化

お客様の製品を実現するための高付加価値部品

ヒートシンク製品

- 民生用ヒートシンク
- 衛星用ヒートシンク
- 通信用キャリア
- 高出力レーザー用CuWサブマウント
- 高出力レーザー用CACサブマウント

ガラス製品

- 磁気ヘッド用ガラス切断
- 回折格子ガラス切断
- センサー用ガラスチップ
- センサー用ガラスウェハー
- MEMS用インターポーザー/ガラスウェハー
- TGVウェハー
- 医療用ガラスウェハー
- スマートフォン用 カバーガラス/ガラススペーサー
- 医療用流路部品
- プロジェクター
- LiDAR車載
- 医療用キャップガラス

その他製品

- マグネット材料切断
- センサー用シリコンチップ
- シリコンボード
- センサー用シリコンウェハー
- DNAシーケンサー用シリコンウェハー

年代別ターニングポイント ①

1980年代前半

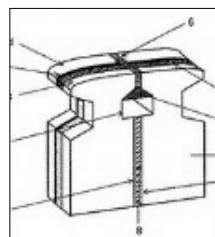
カセットテープの普及に対応し、「磁気ヘッド用のガラスを加工」して提供

民生品でボリュームを
獲得した当時の代表的
製品です



テクニスコ製品

磁気カセット用ガラス



使用技術（導入設備）

切る

- マルチダイシング（スライサー）

削る

磨く

メタライズ

接合

その他

- 積層加工

1980年代

CDの普及に対応し、光ピックアップ部品に使用する「分光プリズム」を提供

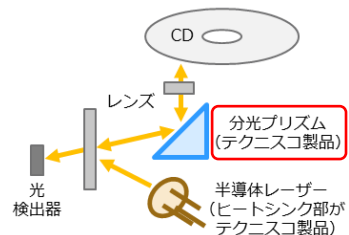
技術力の応用により
「カセットテープ→CD」
という技術の変遷に対
応しました

世の中の技術動向に
素早く対応し、新たな
製品を送り出すという
今のビジネスの基礎を
築きました



テクニスコ製品

分光プリズム



使用技術（導入設備）

切る

- ダイシング（ダイサー）

削る

磨く

メタライズ

接合

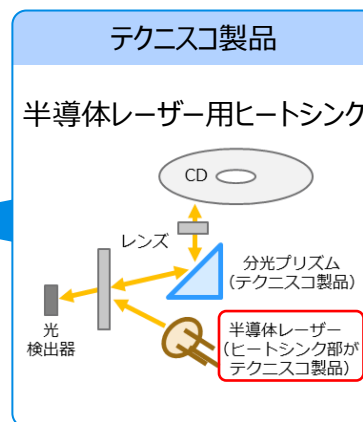
その他

年代別ターニングポイント ②

1980年代

CDの普及に対応し、光ピックアップ部品に使用する「半導体レーザー用ヒートシンク」を提供

顧客の高付加価値部品に対してヒートシンクを提供する契機になり**現在のヒートシンク事業**へとつながりました



使用技術 (導入設備)

切る

- ブランジング切断

削る

磨く

メタライズ

接合

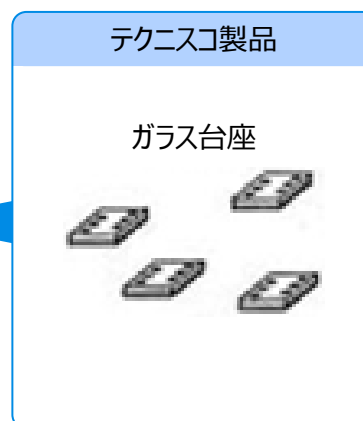
その他

- エッチング

1990年代

ターボエンジンと電子制御の普及に対応し、「自動車センサー向けのガラス製品」を提供

他社にはないガラス、セラミック、シリコンを切断する微細加工技術を有していたため、**大手自動車メーカーと取引を開始する契機**となりました
※ クロスエッジ® Technologyの先駆け



使用技術 (導入設備)

切る

- ダイシング
- ブランジング切断

削る

- 超音波穴あけ加工 (超音波加工機)

磨く

- テクニ研磨 (テクニ研磨機)
- ポリッシュ (ポリッシュ機)
- ラッピング (ラップ機)

メタライズ

接合

その他

年代別ターニングポイント ③

1990年代

衛星の通信用機器パッケージに「低消費電力、電磁波コントロールのメタルチップ」を提供

1990年代から、信頼性と高い品質が求められる**宇宙ビジネスに参入**しており、顧客との良好な関係性を築いています



テクニスコ製品

メタルチップ



(1.5×0.8mm)

使用技術（導入設備）

切る

- ダイシング
- ブランジング切断

削る

磨く

メタライズ

- めっき

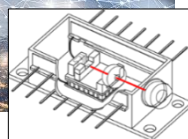
接合

その他

1990年代

世界的な光通信の普及に対応し、「光発信機用のヒートシンク」を提供

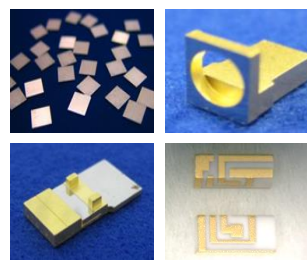
切断の他にも様々な加工の可能性を模索していた時期に2000年の通信バブルが重なり、**クロスエッジ® Technology**を展開する契機となりました



光発信機

テクニスコ製品

光発信機用ヒートシンク



使用技術（導入設備）

切る

- ダイシング
- ブランジング切断

削る

- CNC加工

磨く

- バレル研磨加工（バレル加工機）

メタライズ

- めっき加工（めっき装置）

接合

- ロウ付け接合（連続焼成炉）

その他

年代別ターニングポイント ④

2010年代

スマートフォンの急激な普及に対応し、「タッチパネル一体カバーガラス」に特殊加工を提供

2000年の通信バブルでのヒートシンク製品に続く、**当社の大ヒット製品**になりました
技術力で顧客製品の重要課題を解決したためです



使用技術（導入設備）

切る

削る

磨く

メタライズ

接合

その他

- 穴あけ（内製穴あけ工具開発）

- 積層エッチング

2010～2020年代

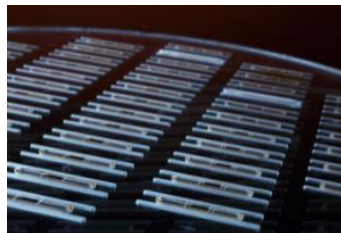
医療診断・分析機器の進化に対応し、体内埋込デバイス用の「ガラスキャップ」を開発

人々の健康寿命の延伸に貢献するために、**ライフサイエンスの先端分野へ積極的に参入**

心臓をモニタリングし、異常信号を検知して薬物投与するデバイス

テクニスコ製品

体内埋込デバイス用ガラスキャップ



使用技術（導入設備）

切る

削る

磨く

メタライズ

接合

その他

- CNC加工
- テクニ研磨（テクニ研磨機）
- ポリッシュ（ポリッシュ機）ラッピング
- スパッタ
- エッチング
- ガラス接合

年代別ターニングポイント ⑤

2010～2020年代

EV・自動運転へのシフトに対応し、LiDARデバイス用の「立体配線ガラス」を提供

三次元形状に配線が可能なガラス製品を開発

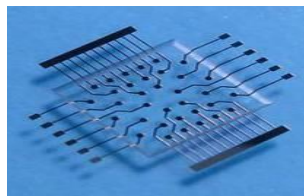
LiDARのように、ますます高性能化が求められる、**小型化・軽量化が必要な電子機器分野**において採用拡大が見込まれます



※LiDAR: light detection and ranging
(レーザー光による検知と距離測定)

テクニスコ製品

立体配線ガラス
(レーザー発光デバイスに使用)



使用技術（導入設備）

切る

削る

磨く

メタライズ

接合

その他

- ブラスト穴加工
- テクニ研磨（テクニ研磨機）
- ポリッシュ（ポリッシュ機）ラッピング
- フォトリソ
- ガラス接合
- エッチング

将来の見通しに関する注意事項

- 本資料は、当社に関する情報提供を目的としたものであり、国内外を問わず、いかなる有価証券、金融商品または取引に関する募集、投資の勧誘または売買の推奨を目的としたものでもありません。本資料は、金融商品取引法またはその他の法令もしくは諸規則に基づく開示書類ではありません。
- 本資料には、当社およびそのグループ会社（以下、当社と併せて「当社グループ」という。）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記載が含まれています。これらは、当社が本資料作成時点において入手した情報に基づく、当該時点における予測等を基礎として作成されています。これらの記載は、一定の前提および仮定に基づいており、また、当社の経営陣の判断または主観的な予想を含むものであり、国内外の経済状況の変化、市場環境の変化、社会情勢の変化、他社の動向等の様々なリスクおよび不確実性により、将来において不正確であることが判明または将来において実現しないことがあります。したがって、当社グループの実際の業績、経営成績、財政状態等については、当社の予想と異なる結果となる可能性があります。
- 本資料に記載されている当社グループ以外の企業等に関する情報および第三者作成にかかる情報は、公開情報または第三者が提供する情報等から引用したものであり、そのデータ、指標、分析等の正確性、適切性等について、当社は独自の検証を行っておらず、何らその責任を負いません。なお、当社グループに関する情報の本資料への掲載に当たっては万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、公正性および確実性を保証するものではありません。
- 本資料における将来情報に関する記載は、上記のとおり本資料の作成時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新する義務も方針も有しておりません。

株式会社テクニスコ 経営サポート本部
03-3458-4561